

公司代码：603936

公司简称：博敏电子

**博敏电子股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为：拟以截止2022年度实施权益分派股权登记日总股本638,023,104股扣除回购专户上已回购股份数量7,625,100股后的总股本为基数，每10股派现金0.2元（含税），预计派发现金股利12,607,960.08元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。以上预案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 博敏电子 | 603936 | 无       |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                  | 证券事务代表               |
|----------|------------------------|----------------------|
| 姓名       | 黄晓丹                    | 陈思                   |
| 办公地址     | 广东省梅州市东升工业园B区          | 广东省梅州市东升工业园B区        |
| 电话       | 0753-2329896           | 0753-2329896         |
| 电子信箱     | xd_huang@bominelec.com | s_chen@bominelec.com |

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1、PCB 行业发展

##### （1）全球 PCB 市场规模稳步扩容，2027 年产值近千亿美元

PCB 作为现代电子产品中不可或缺的电子元器件，广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域。伴随 5G 时代下物联网、AI、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现，PCB 行业正迎来新一轮发展周期。

受益于下游行业不断向多元化拓展以及下游需求扩张的拉动，全球 PCB 市场规模稳步增长。根据 Prismark 报告指出，受全球金融环境收紧、俄乌冲突、美国出口管制、能源市场动荡、美元升值带来的汇率变化等问题的影响，2022 年全球 PCB 市场产值达 817.40 亿美元，同比上升 1%。中长期来看未来全球 PCB 行业仍将呈现增长趋势，Prismark 预测 2027 年全球 PCB 市场规模有望

达到 983.88 亿美元，2022-2027 年全球 PCB 产值复合增长率约为 3.8%，中国 PCB 产值复合增长率约为 3.3%，略低于全球，预计到 2027 年中国 PCB 产值将达到约 511.33 亿美元。

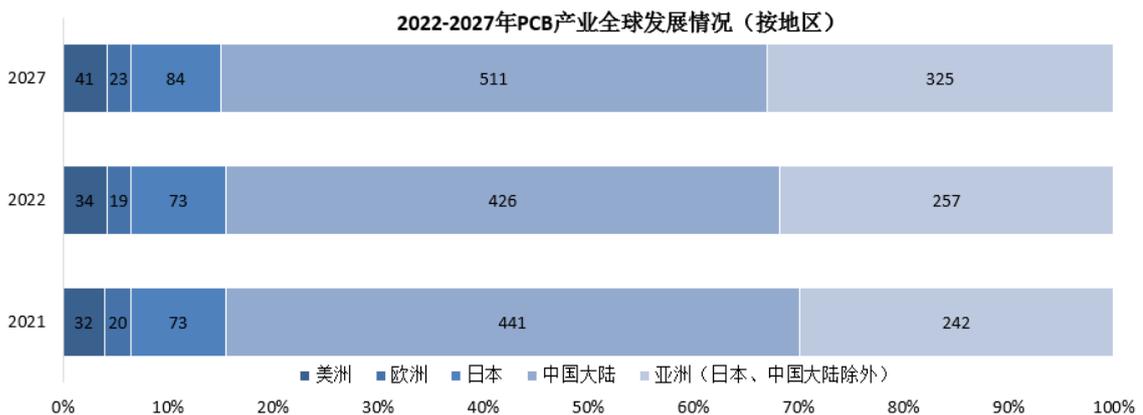
2015 年至 2022 年，全球 PCB 行业产值及其变化情况如下图所示：



### (2) 中国依旧为产量最大区域，增长态势稳健

目前，中国大陆以超过 50% 的市场份额居于世界 PCB 产业的主导地位，成为全球 PCB 行业产量最大的区域。

从区域表现而言，全球各区域 PCB 产业未来均呈现持续增长态势。受制于 2022 年国内整体经济增长乏力、需求不振的影响，2022 年中国大陆地区 PCB 产值预计为 435.53 亿美元，同比下滑 1.4%；但从中长期看，预计 2027 年中国 PCB 市场规模有望达到 511.33 亿美元，2022-2027 年复合增长率为 3.3%，将保持稳健的增长态势。（数据来源：Prismark）

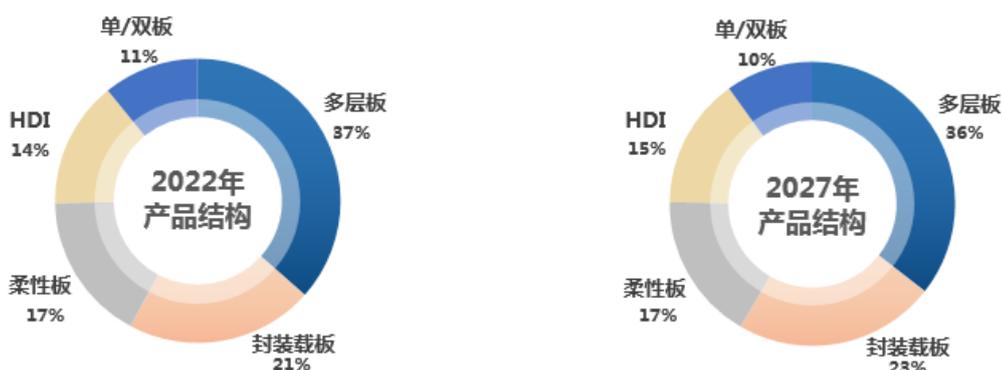


### (3) 多层板占据 PCB 产品的主流地位，封装基板、HDI 板增速亮眼

根据 Prismark 2022Q4 统计，在 2022 年全球 PCB 产品类别中，多层板占比高达 37%，占比持续保持领先。随着消费电子更迭、汽车电子兴起、5G 物联网落地，PCB 产品逐步向轻薄化、高性能、高密度、高频高速等方向发展，封装基板、柔性板、HDI 占比逐步上升，2022 年这三类产品占比分别为 21%、17% 和 14%，不断挤占多层板和单/双面板的份额。从产品结构而言，IC 封装基板、HDI 板仍将呈现优于行业增速的表现。据 Prismark 预测，2022-2027 年封装基板、HDI 板、

18层及以上的高多层板、8-16层的高多层板仍将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为5.1%、4.4%、4.4%、3.9%。

| 全球产品结构<br>表现     | 2022年       |       | 2027年      | 2022年-2027年<br>复合增长率 E |
|------------------|-------------|-------|------------|------------------------|
|                  | 产值 E (百万美元) | 同比    | 产值 E(百万美元) |                        |
| 纸基板/单面板<br>/双面板  | 8,875       | -7.4% | 9,813      | 2.0%                   |
| 4-6层板            | 17,836      | -4.6% | 20,634     | 3.0%                   |
| 8-16层板的高<br>多层板  | 10,288      | -3.6% | 12,468     | 3.9%                   |
| 18层板及以上<br>的高多层板 | 1,722       | 1.8%  | 2,133      | 4.4%                   |
| HDI板             | 11,763      | -0.4% | 14,581     | 4.4%                   |
| 封装载板             | 17,415      | 20.9% | 22,286     | 5.1%                   |
| 柔性板              | 13,842      | -1.5% | 16,473     | 3.5%                   |
| 合计               | 81,740      | 1.0%  | 98,388     | 3.8%                   |



未来无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是 PCB 行业长期的重要增长驱动力。为适应不同领域的需求，PCB 正向着高速、高频、集成化、小型化和轻薄化的方向发展，高多层、高频高速、HDI 等中高端 PCB 产品将保持强劲增长趋势。

## 2、陶瓷基板行业发展情况

### (1) 陶瓷基板在未来享百亿美元市场规模，AMB 工艺增速亮眼

目前，电子封装技术正向小型化、高密度、多功率和高可靠性的方向发展，常用的基板材料主要有塑料基板、金属基板、陶瓷基板和复合基板四大类。陶瓷基板凭借其优异的热性能、微波性能、力学性能以及可靠性高等优点，在高频开关电源、半导体、IGBT、LD、LED、CPV、VCSEL 封装中的应用起到重要作用，包含高端陶瓷基板的电子元器件模组被广泛应用于移动通信、计算机、家用电器及汽车电子等终端领域。

近年来，随着大功率半导体元器件 LED、IGBT 等的迅速发展，陶瓷基板需求随之增加。根据日商环球讯息有限公司 (GII)《陶瓷基板：全球市场的展望 (2021 年~2028 年)》报告，2021 年全球陶瓷基板的市场规模为 70.2 亿美元，预计 2028 年达到 120.3 亿美元，期间年均复合增长率为 8.0%。

| 全球市场规模 (亿美金, %) | 应用领域 |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

|      | 2020 | 2026E | CAGR |                                   |
|------|------|-------|------|-----------------------------------|
| DBC  | 2.9  | 4.0   | 8.6  | IGBT 功率器件、汽车领域、聚光光伏 (CPV)、航空航天    |
| AMB  | 4.0  | 16.0  | 25.0 | IGBT 功率器件、汽车领域、家用电器、航空航天          |
| DPC  | 12.0 | 17.0  | 5.2  | LED 产品、激光器 LD、VCSEL               |
| HTCC | 5.1  | 8.9   | 7.0  | 高频无线通信、航空航天、存储器、驱动器、滤波器、传感器、汽车电子  |
| LTCC | 65.0 | 127.0 | 10.1 | 手机、蓝牙、GPS 模块、WLAN 模块、WIFI 模块、汽车电子 |

资料来源：GII，艾邦半导体网

## (2) 陶瓷基板全球供给竞争激烈，高端化下国产替代有望提速

全球陶瓷基板市场竞争激烈，据 GII 调研数据显示，2019 年村田和京瓷的市场份额分列一二，营收合计占据全球总额的约 33.15%。日本是全球最大的陶瓷基板生产市场，其陶瓷基板市场以村田、京瓷和丸和等核心厂商为主导。而欧洲则是全球第二大的生产市场，核心厂商是罗杰斯，在全球市场中位居第三。我国正成为世界电子元件的生产大国和出口大国。随着国际电子信息产品制造业加速向中国转移，下游企业出于相关采购和运输成本的考虑，势必会加大本地化采购比例。

随着近年来大功率半导体元器件 LED、IGBT 等的迅速发展和使用，高端陶瓷线路板发展前景广阔。由于其具备特殊技术要求，加上设备投资大、制造工艺复杂，目前全球核心制造技术主要掌控于罗杰斯、韩国 KCC、申和、博世等少数几家知名企业手里。国内现有技术尚无法实现高端陶瓷基板的大规模产业化生产，但面对当前人工智能、IGBT 功率器件、汽车领域、聚光光伏 (CPV)、通信、航天航空及其他领域市场迫切增长的需求，无论是国家政府还是国产企业，均希望能实现重大技术突破，改变陶瓷基板长期依赖进口的局面。

## (3) AMB 引领大功率 IGBT 及第三代半导体模块封装新趋势

AMB 工艺生产的陶瓷衬板主要运用在功率半导体模块上作为硅基、碳化硅功率芯片的基底，目前国内的 IGBT 模块大部分还是采用 DBC 工艺。但随着工作电压、性能要求的不断提升，AMB 工艺技术的陶瓷衬板能更好地解决上述痛点。相比之下，AMB 技术实现了氮化铝和氮化硅陶瓷与铜片的覆接，相比 DBC 衬板有更优的热导率、铜层结合力、可靠性等，可大幅提高陶瓷衬板可靠性，更适合大功率大电流的应用场景，逐步成为中高端 IGBT 模块散热电路板的主要应用类型，在汽车、航天、轨道交通、工业电网领域等广泛应用。

此外，由于 AMB 氮化硅基板有较高热导率 ( $>90\text{W/mK}$ )，可将非常厚的铜金属 (厚度可达 0.8mm) 焊接到相对薄的氮化硅陶瓷上，载流能力较高。且氮化硅陶瓷基板的热膨胀系数与第三代半导体衬底 SiC 晶体接近，使其能够与 SiC 晶体材料匹配更稳定，因此成为 SiC 半导体导热基板材料首选，特别在 800V 以上高端新能源汽车中应用中不可或缺。

## (4) 新能源需求助推 IGBT 迈向新高度，800V 高压平台为 SiC 带来新机遇

IGBT 被广泛应用在工业控制、新能源汽车、光伏风电、变频白电、智能电网以及轨道交通等领域。据东吴证券预测，随着下游领域的快速发展，2025 年中国 IGBT 市场空间将达到 601 亿元，CAGR 高达 30%。其中，增速最快的细分市场是新能源汽车 IGBT，预计 2025 年我国新能源汽车的 IGBT 需求将达到 387 亿元，CAGR 高达 69%。

同时，碳化硅 800V 高压平台为碳化硅带来全新发展机遇。目前纯电动乘用车的用户痛点为充电速度较慢，进一步提高电压可以提高纯电动乘用车补能速度。当前，众多主机厂正加速布局 800V

高压平台，预计 2023-2024 年将迎来 800V 高压平台的快速发展期。整车上到高压平台后最重要的部件升级为电驱，而在功率模块中使用碳化硅器件是电驱升级的核心。因此，受新能源汽车应用需求的带动，碳化硅器件市场将高速增长。据 Yole 预测，全球碳化硅器件市场将从 2021 年 10 亿美元的规模增长至 2027 年的 60 亿美元以上，复合增速将高达 34%；其中汽车碳化硅器件的市场将从 2021 年的 6.85 亿美元增长至 2027 年的约 50 亿美元，复合增速高达 40%。

### 3、公司产品细分领域情况及行业地位

公司深耕 PCB 行业 29 年，布局多元化产品结构的同时，聚焦 HDI 板、高多层板和封装载板等高端产品以加速量产。公司 2011 年已实现 HDI 板量产，掌握任意阶产品的生产工艺技术，并通过募投项目进一步提升 HDI 板的出货占比。公司基于自身 HDI 生产工艺优势，自 2018 年开始筹备 IC 载板项目人才和技术，目前已具备量产能力，进一步拓展公司 PCB 产品宽度和产量规模。公司在第二十一届（2021）中国电子电路行业内资 PCB 企业排名 12 位；综合 PCB 企业排名 25 位。根据 PrismaMark 2021 年全球 PCB 百强企业排名显示，公司位列第 43 名。此外，公司还是中国电子电路行业百强企业、第五届“中国电子电路行业优秀企业”、“国家知识产权示范企业”，是中国电子电路行业协会（CPCA）副理事长单位、深圳市电路板行业协会（SPCA）副会长单位和梅州市印制电路行业协会（MPCA）名誉会长单位。

同时，公司作为国内稀有的已实现量产的陶瓷衬板生产商，目前国内 AMB 陶瓷基板产能相对较小，产品主要依赖进口。据艾邦陶瓷展不完全统计，国内 AMB 陶瓷基板企业有 15 家，公司 AMB 产能规模在上述企业中排名第二。基于航空航天、轨道交通领域积累的客户和制造经验，掌握了薄膜和 DPC 陶瓷衬板制作能力，进而扩展功率器件中 AMB 陶瓷衬板业务。公司目前已利用独立自主的钎焊料，全面掌握烧结、图形蚀刻到表面处理全工艺流程并在国内率先产业化，在空洞率、冷热冲击可靠性测试、覆铜能力、表面处理能力、成本和产能方面拥有明显的领先优势。

未来，随着服务器、新能源汽车、第三代半导体等高景气度行业发展，国内 PCB 企业有望凭借工艺技术优势和供应链响应服务能力，在 HDI 板、封装载板和 AMB 陶瓷衬板上持续提升国产化率。相应地，公司产品也将顺应产业发展趋势逐步释放扩产产能，进一步提升公司在 PCB 和陶瓷衬板的行业地位。

#### （一）主营业务、主要产品及用途

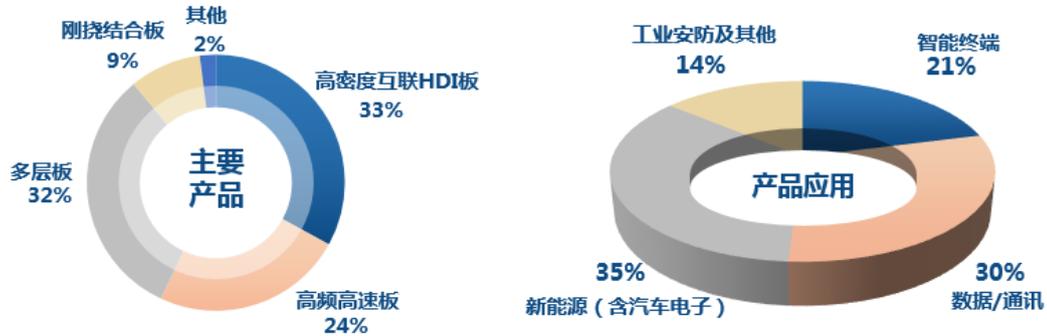
公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售起家，不断通过内生发展与外延并购相结合的方式，以 PCB 为内核，从横向和纵向两个维度进行业务延伸（PCB+），持续加大定制化电子器件、模块化产品、微芯器件等高附加值产品的研发与开拓力度，形成了主营业务+创新业务的模式，在拓展公司产业链及产品应用领域的同时为打造公司的长期增长曲线夯实了基础。报告期内，公司业务全景如下图所示：



(蓝色部分为博敏业务领域)

## 1、主营业务

公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为高密度互联 HDI 板、高频高速板、多层板、刚挠结合板（含挠性电路板）和其他特殊规格板（含：金属基板、厚铜板、超长板等），覆盖行业以新能源/汽车电子、数据/通讯、智能终端、工控安防为主，重点聚焦新能源汽车、储能、高性能服务器、MiniLED 等细分赛道。



## 2、创新业务

报告期内，公司紧跟国家在新基建、碳中和、万物互联等政策的引导，结合公司情况和市场需求，依托主营业务的规模优势、技术储备和客户积累，布局新的业务板块，为公司提供新的业绩增长点。

### (1) 陶瓷衬板

陶瓷衬板又称陶瓷电路板，作为公司创新业务之一，供应链下游主要包括轨交、光伏、储能和新能源汽车等领域。它是在陶瓷基片上通过覆铜技术形成的基板；再通过激光钻孔、图形刻蚀等工艺制作成陶瓷电路板。公司具备 AMB、DPC 陶瓷衬板生产工艺，AMB 工艺生产的陶瓷衬板主要

运用在功率半导体模块上作为硅基、碳化硅功率芯片的衬底，DPC 工艺生产的陶瓷衬板主要运用在激光雷达、激光热沉、器件衬底。该业务率先在航天航空可靠性运用，降维到车规级、工业级、轨交级，车规级的客户从 2020 年开始认证，2022 年已在多家功率半导体企业成功认证，后续将逐步完成招标、量产工作。

公司拥有国际领先的 AMB 工艺技术和生产流程，相关产品已在轨道交通、工业级、车规级等领域取得认证，先后在航空体系、中车体系、振华科技、国电南瑞、比亚迪半导体等客户中开展样板验证和量产使用。公司 AMB 陶瓷衬板一期具备产能 8 万张/月，处于国内前列，从去年第四季度开始配合客户需求进行扩产，预计 2023 年有望达到 15-20 万张/月的产能规模；合肥经济技术开发区管理委员会也敏锐地发现了陶瓷衬板的发展先机，跟公司开展 50 亿元的陶瓷衬板及 IC 封装载板产业基地项目，其中，陶瓷衬板项目投资 20 亿元，计划 2023 年 Q4 开工建设，2024 年二季度竣工投产，项目达产后预计实现产能 30 万张/月。

## **(2) 封装载板**

IC 载板，也叫封装载板，属于行业比较前沿的技术，是 IC 封装中用于连接芯片与 PCB 母板的重要材料，已在中高端封装领域取代了传统的引线框。封装载板在结构及功能上与 PCB 类似，由 HDI 板发展而来，但封装载板的技术门槛要远高于 HDI 和普通 PCB，在线宽/线距等多种技术参数上都具备更高要求。由于具有高密度、高精度、高脚数、高性能、小型化及薄型化等特点，号称 PCB 皇冠上的明珠。

公司 2009 年开始涉足 HDI，具备成熟和先进的 HDI 生产工艺技术。子公司江苏博敏率先布局“技术同源”的封装载板业务，生产的封装载板产品覆盖种类多样，包括模组类封装载板、存储类封装载板等，应用领域主要包括智能终端、芯片/存储等，实现 PCB 向又一高端技术的延伸。

## **(3) 全供应链增值服务**

公司依托 PCB、陶瓷衬板等优势产品，向客户提供电子装联、功能测试、模块/产品组装、EMS/ODM 等全供应链增值服务，形成了优质、高效、稳定且具备成本优势的供应链体系，涉及领域从家电延伸至军工、新能源（汽车、电单车、储能）、功率半导体等，能够满足细分领域龙头客户对产品品质及成本管控的要求，实现多方共赢。

未来，集成化、高压化是新能源汽车的重要发展趋势，多合一电驱动系统及高电压平台正加速渗透。大功率模组电子装联业务依托 PCB 事业群的专利产品——强弱电一体化特种电路板衍生而来，有效解决了高度集成问题，同时提高续航里程，是集设计、生产、装联、调试的一站式服务业务，旨在成为新能源汽车功率控制模块的专业 PCBA 方案解决商。该业务的设计团队成立超过 5 年，拥有数百例设计案例的经验，设计能力涵盖商用车、乘用车的电池 PACK、BDU、PDU、OBC、VCU 等。公司配备专业化的生产管理队伍和车规级的电子装联车间，可满足客户高质量、快速响应的服务需求。此外，强弱电一体化 PCB 助力三电系统的高集成和模块化，提高生产效率，从而降低生产成本。目前该业务已经与多家造车新势力客户对接、合作中。

高性能无源器件是基于陶瓷基板进行薄膜沉积技术制造的，目前已相继开发了隔离器、环形器、功分器、电阻器、电桥、螺旋电感等八大货架产品，产品性能在国内外均达到较高水平，助力国产化替代。

## **(二) 公司主要经营模式**

### **1、生产模式**

公司实行以销定产的生产模式。集团产策中心负责把所接收的订单进行初步评审，结合各厂产能及产品定位分配订单，各厂计划部按照产策分配的订单，结合客户交期进行排产，产线按照计划要求严格执行，完成生产任务。

公司已建立一套高集成度的 ERP 信息化系统，涵盖了生产制造、工程管理、品质管理、库存管理、成本管理、商业智能等十大模块。通过该系统，计划部可对生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调营销、供应链、制造等相关部门，保障生产有序进行，为客户提供满意的产品和服务。产线各工序设置了电子看板，可以随时了解排产和生产执行情况，进行机台稼动率管理等。当产能无法满足订单需求时，相关人员可以快速识别出瓶颈工序，及时将部分瓶颈的生产环节（如钻孔、压合等）外包给其他有资质的企业完成。公司已设立专业的团队对外协商进行管理，确保外协品质和交期满足客户需求。

另外，公司每年根据战略要求，梳理瓶颈工序，实施技改升级，促使流量流速最大化，及时评估扩产的必要性，不断提升顾客满意度，提高产品市场占有率。同时，公司高度重视系统建设，紧随生产技术变革趋势，提高生产自动化和智能化水平，运用现代信息化管理手段进行科学管理，为公司的高速发展提供强有力的保障。

## 2、采购模式

集团设有供应链管理总部，负责对集团及下属子公司的采购活动和供应商管理，主要职能包括：对主材、设备、工程类采购工作进行集团化管理，推动集团数字化及体系建设进程。搜集行业资讯，审核供应商的相关资质及报价合理性，同时协助各子公司进行成本管控，监督各子公司采购及物控日常工作的有效执行。

总部设立物料、设备工程类集采组，负责执行集团采购策略，整合资源，推动降本工作。通过对内建立 ERP、OA 等系统平台，对外建立供应商门户网，实现数字化、信息化供应商管理及采购流程管理的目的。各子公司均设有独立的采购部，负责本子公司各材料比价的初步洽谈、完成订单履约、异常跟进，执行集团采购策略等工作。

公司制定了《采购控制程序》《供应商管理程序》《供应商评估认证作业指导》《采购合同管理作业规范》等文件以严格控制公司对供应商的管理及对采购作业规范化。针对不同特性的原材料，公司采取不同方式进行采购：针对大宗材料、占额较高材料的采购，与供应商的合作方式为寄售，以达到不占用公司库存及流动资金的目的；针对难以管控耗用量材料的采购，与供应商合作方式为包线、包尺、包电量，以降低采购成本。

## 3、销售模式

公司始终秉持“以客户为中心，为客户创造价值”的理念，在公司核心发展领域积极开拓国内外行业标杆客户，与客户构建共赢、共发展的良好合作关系。

按照公司战略发展规划，产品和应用领域聚焦在电源/储能、数据通讯、汽车电子和智能终端等领域的优质客户；根据产业客户需求和公司产品特色，采用分区域和分部门相结合的组织架构模式，建立以区域营销和产品线销售相结合的销售模式。公司 PCB 事业群设立营销中心，作为公司对接客户的统一窗口，并按照供-产-销的高效对接机制来安排客户订单生产需求。

公司不断开拓国内外优质客户，不仅在国内华南、华东市场建立销售团队来满足客户需求，并且设立分支机构拓展海外市场。

公司与终端品牌客户或 OEM、ODM 客户签订“产品框架协议”或“质量保证协议”等，约定产

品的质量标准、交货方式、结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，并约定产品规格、销售价格、数量和交期等。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                        | 2022年            | 2021年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2020年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 6,918,501,818.02 | 6,551,683,119.37 | 5.60           | 5,563,756,228.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,682,270,819.53 | 3,615,559,573.30 | 1.85           | 3,501,542,419.85 |
| 营业收入                   | 2,912,387,717.13 | 3,520,660,207.12 | -17.28         | 2,785,506,052.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 78,584,644.08    | 241,871,903.43   | -67.51         | 246,713,503.86   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,334,499.85    | 211,199,999.34   | -76.17         | 217,271,122.08   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 203,456,324.92   | 272,949,728.81   | -25.46         | 71,101,428.66    |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.15             | 6.83             | 减少4.68个百分点     | 9.36             |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.15             | 0.48             | -68.75         | 0.55             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.15             | 0.47             | -68.09         | 0.55             |

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                    | 660,894,177.00  | 873,564,491.07  | 691,187,962.39  | 686,741,086.67    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 40,586,196.25   | 68,877,109.27   | 20,496,462.16   | -51,375,123.60    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,632,130.77   | 66,193,482.67   | 15,944,427.37   | -63,435,540.96    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -43,185,942.53  | 107,763,410.43  | 90,503,064.70   | 48,375,792.32     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户）                           |  |            |           |                      | 29,387         |            |       |
|--|--|------------|-----------|----------------------|----------------|------------|-------|
| 年度报告披露日前一月末的普通股股东总数（户）                     |  |            |           |                      | 36,271         |            |       |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                     |  |            |           |                      | 0              |            |       |
| 年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                |  |            |           |                      | 0              |            |       |
| 前 10 名股东持股情况                               |  |            |           |                      |                |            |       |
| 股东名称<br>（全称）                               | 报告期内<br>增减   | 期末持股<br>数量 | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |            | 股东性质  |
|  |  |            |           |                      | 股份<br>状态       | 数量         |       |
| 徐缓   | 0  | 70,661,419 | 13.83     | 0                    | 质押             | 35,330,000 | 境内自然人 |
| 谢小梅  | -6,710,000   | 39,035,380 | 7.64      | 0                    | 质押             | 10,500,000 | 境内自然人 |
| 刘燕平  | -1,070,000   | 22,613,660 | 4.43      | 0                    | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 刘长羽  | 2,750,300  | 17,716,900 | 3.47      | 0                    | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 谢建中  | -4,580,000   | 17,002,860 | 3.33      | 0                    | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 中信证券股份<br>有限公司                             | 3,987,074  | 10,155,282 | 1.99      | 0                    | 无              | 0          | 国有法人  |
| 泰康人寿保险<br>有限责任公司<br>—投连—创新<br>动力           | 9,261,300  | 9,261,300  | 1.81      | 0                    | 无              | 0          | 其他    |
| 周信义  | 7,250,000  | 7,250,000  | 1.42      | 0                    | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 李敏仙  | 3,139,100  | 3,996,600  | 0.78      | 0                    | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 交通银行股份<br>有限公司—博<br>时新兴成长混<br>合型证券投资<br>基金 | 3,958,160  | 3,958,160  | 0.77      | 0                    | 无              | 0          | 其他    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 公司前十名股东中，徐缓与谢小梅系夫妻关系；谢建中与谢小梅系兄妹关系；谢建中与刘燕平系夫妻关系；其中徐缓与谢小梅为控股股东和实际控制人，公司股东徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东（无限售条件股东）之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |            |           |                      |                |            |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                        | 不适用  |            |           |                      |                |            |       |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 291,238.77 万元，比上年同期下降 17.28%；利润总额 9,234.32 万元，比上年同期下降 66.50%；归属于上市公司股东的净利润 7,858.46 万元，比上年同期下降 67.51%，其中扣除非经常性损益的净利润为 5,033.45 万元，比上年同期下降 76.17%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用